

2017年3月期 第1四半期（2016年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2016年7月29日

内容：

- 第1四半期連結決算の概要
- 事業環境および業績予想

代表取締役専務執行役員 堀 哲朗

代表取締役社長、CEO 河合 利樹



第1四半期 連結決算の概要

2016年7月29日

堀 哲朗
代表取締役専務執行役員



2017年3月期 第1四半期のハイライト

- 装置納入タイミングの端境期にあり、売上は前四半期比10%減少の1,479億円。期初想定通り、第2四半期以降は売上増加を見込む
- 3D NANDとファウンドリで、中国と東南アジアのSPE売上が伸長
- 熊本地震関連の特別損失78億円を計上

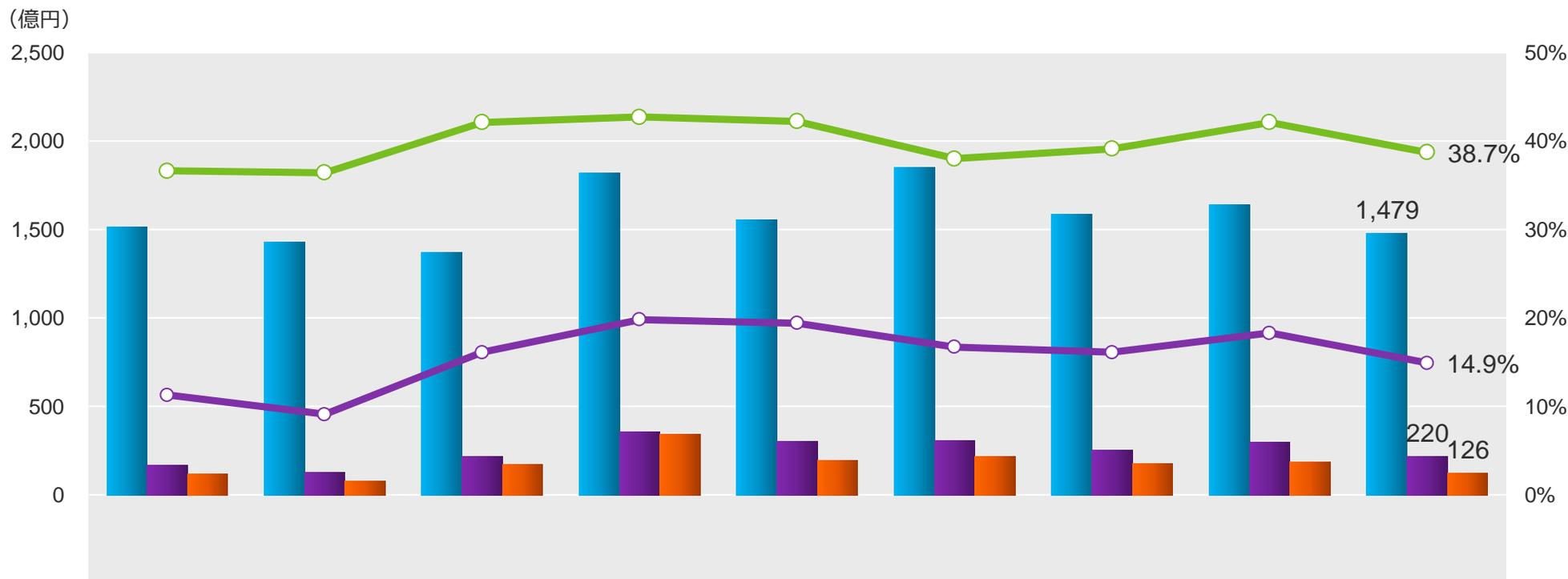
損益状況

(億円)

	2016年3月期				2017年3月期	対前年4Q 増減率
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	
売上高	1,557	1,851	1,587	1,642	1,479	-9.9%
売上総利益 下段：売上総利益率	657 42.2%	703 38.0%	620 39.1%	691 42.1%	573 38.7%	-17.1% -3.4pts
販管費	354	393	365	391	352	-9.9%
営業利益 下段：営業利益率	302 19.4%	309 16.7%	255 16.1%	300 18.3%	220 14.9%	-26.4% -3.4pts
税前利益	290	284	251	238	161	-32.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	194	218	178	186	126	-32.0%
研究開発費	175	200	183	203	177	-12.7%
設備投資額	21	26	28	56	38	-31.3%
減価償却費	46	47	49	49	39	-19.7%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

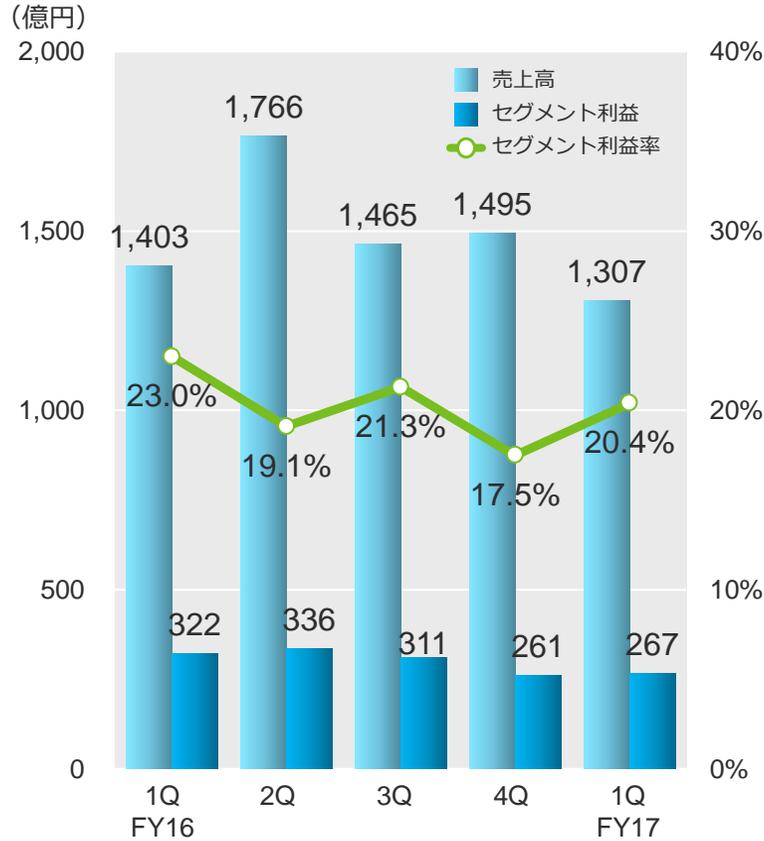
損益状況



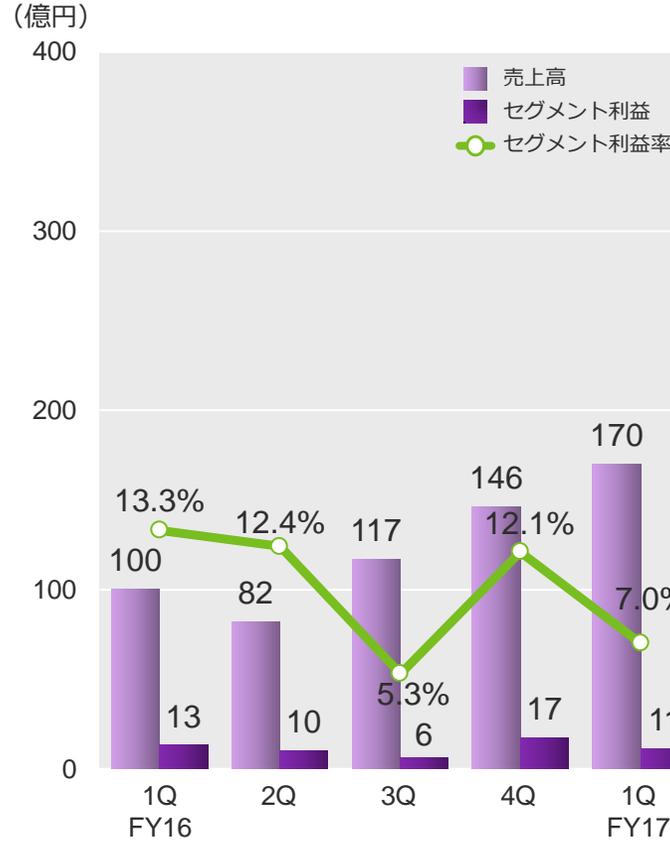
	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17
■ 売上高	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557	1,851	1,587	1,642	1,479
■ 営業利益	170	130	220	359	302	309	255	300	220
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	118	81	174	344	194	218	178	186	126
● 売上総利益率	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%	38.0%	39.1%	42.1%	38.7%
● 営業利益率	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%	16.7%	16.1%	18.3%	14.9%

セグメント情報

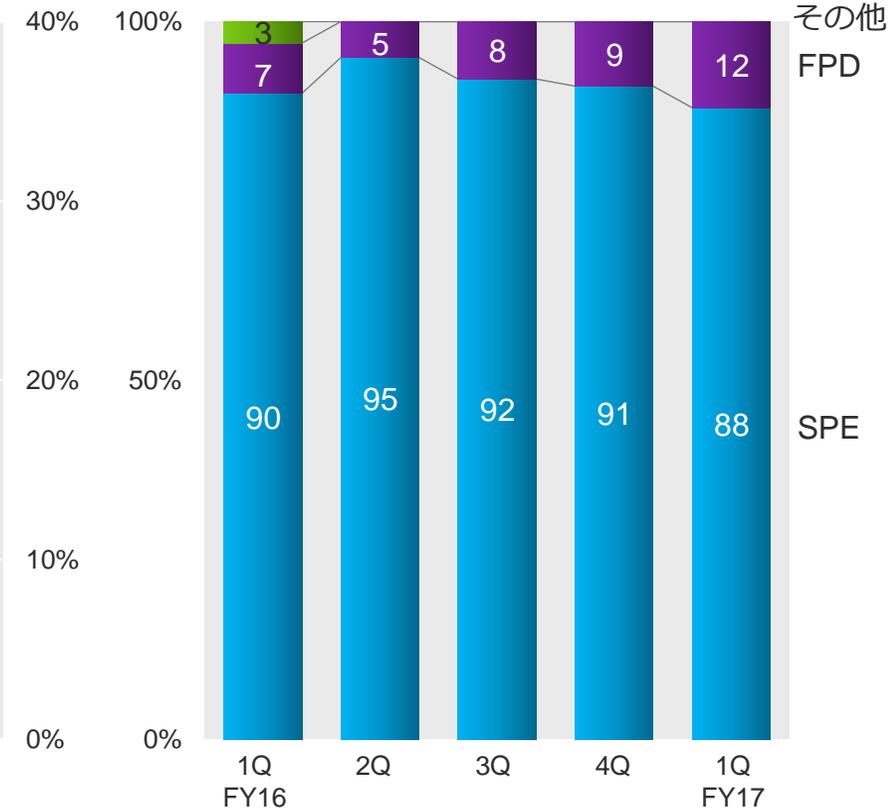
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

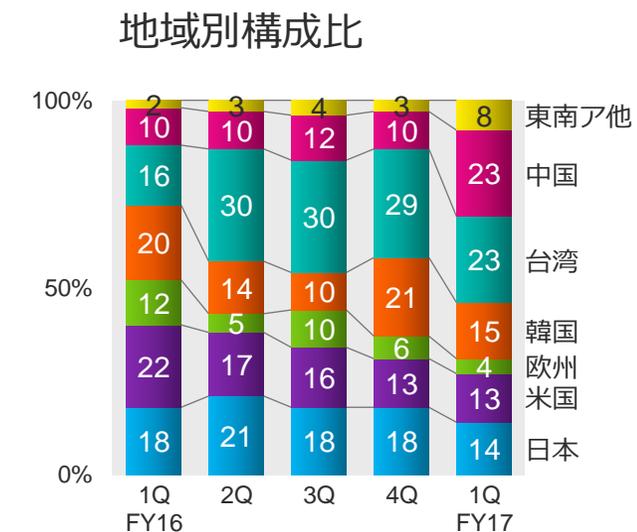
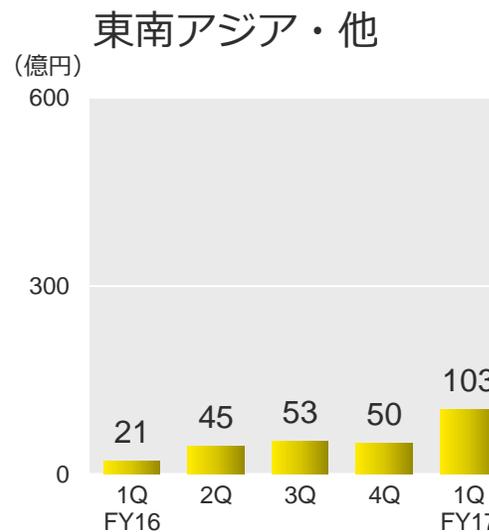
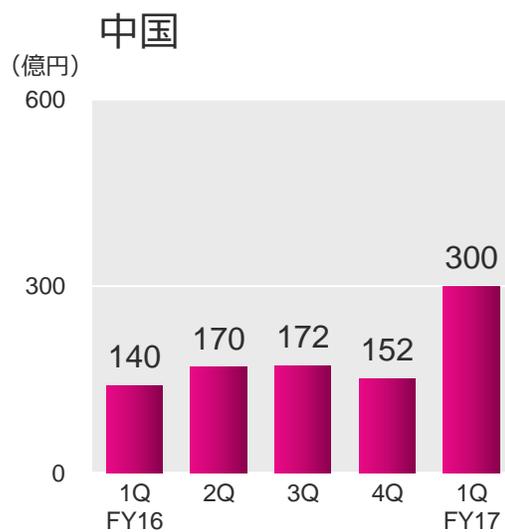
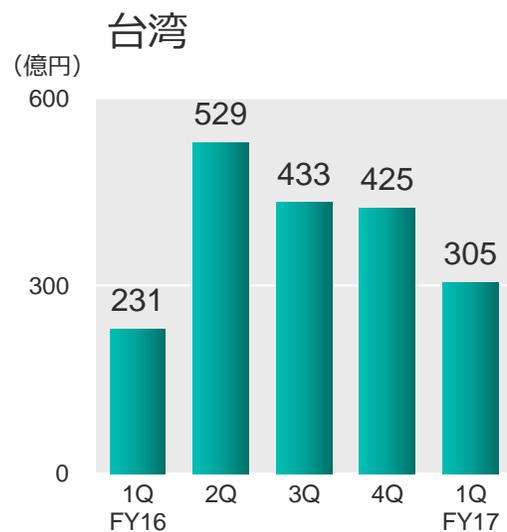
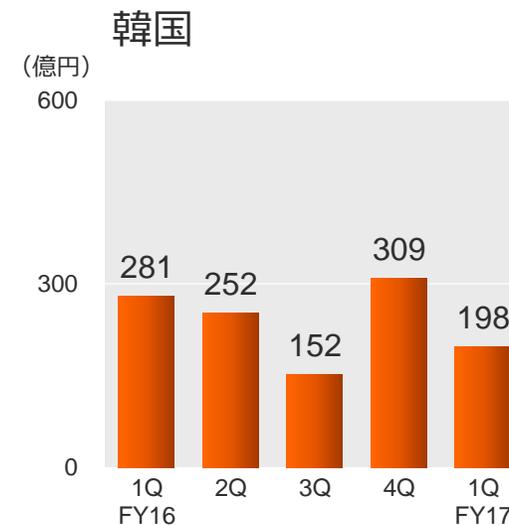
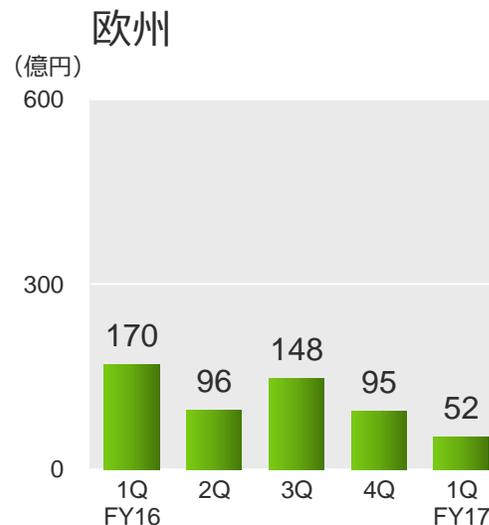
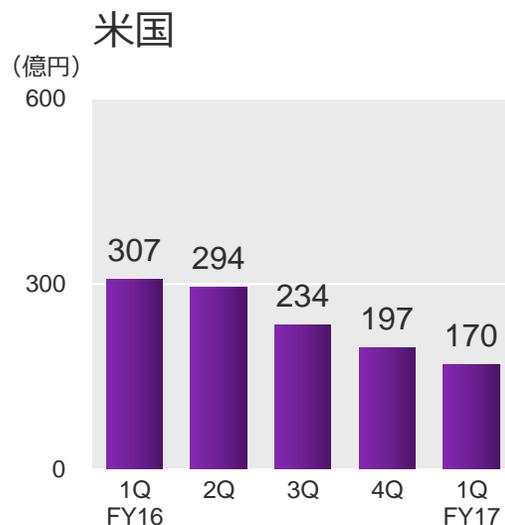
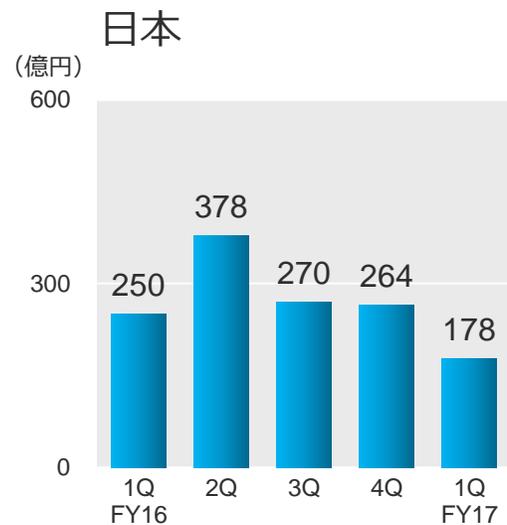


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

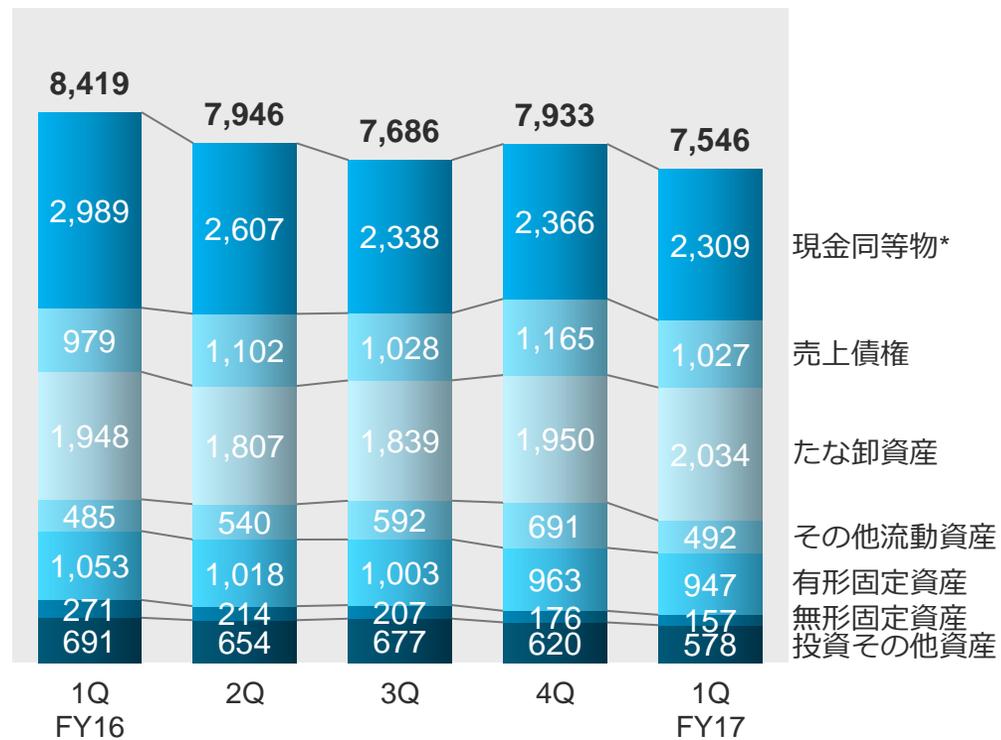
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

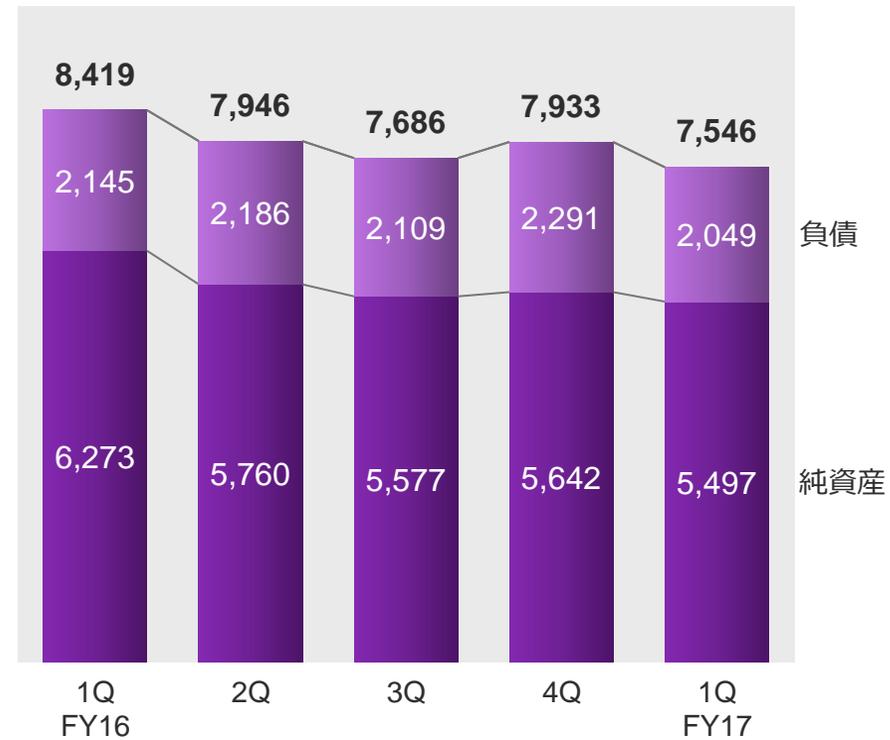
資産

(億円)



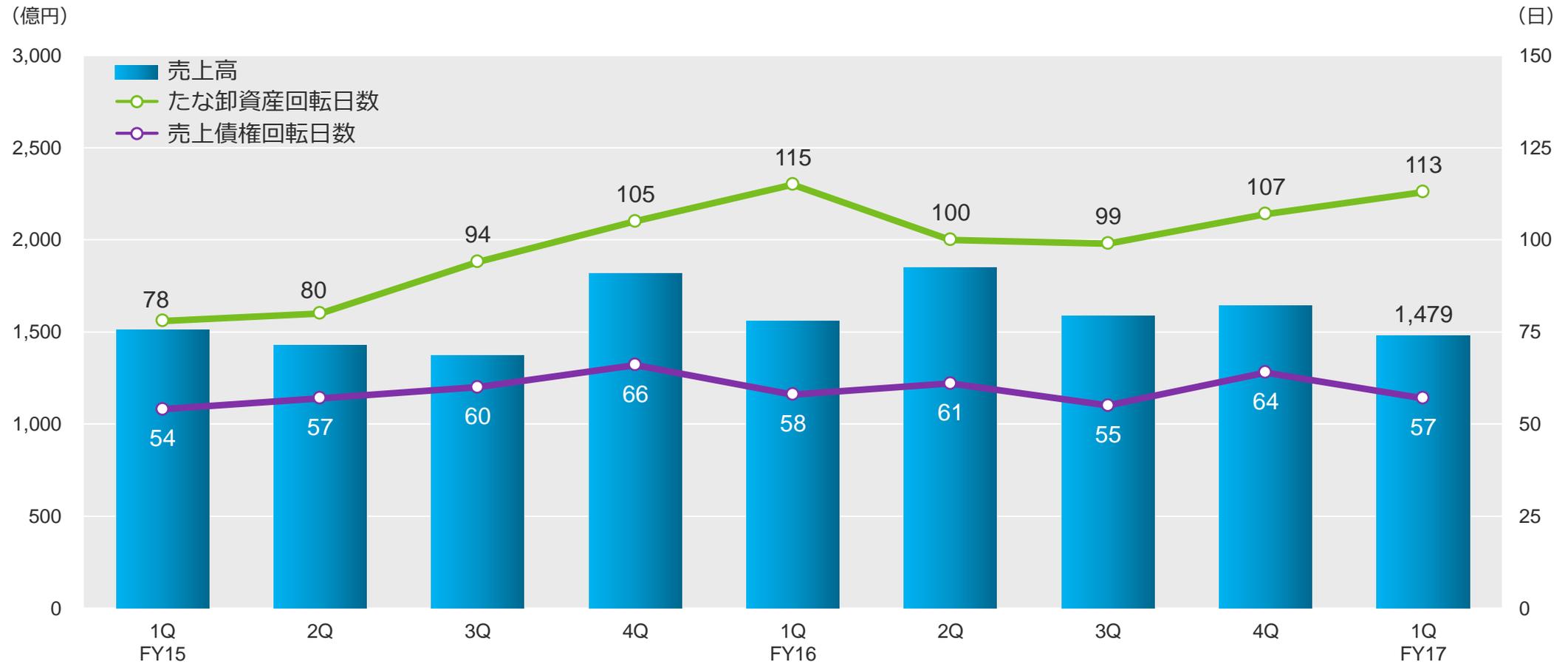
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

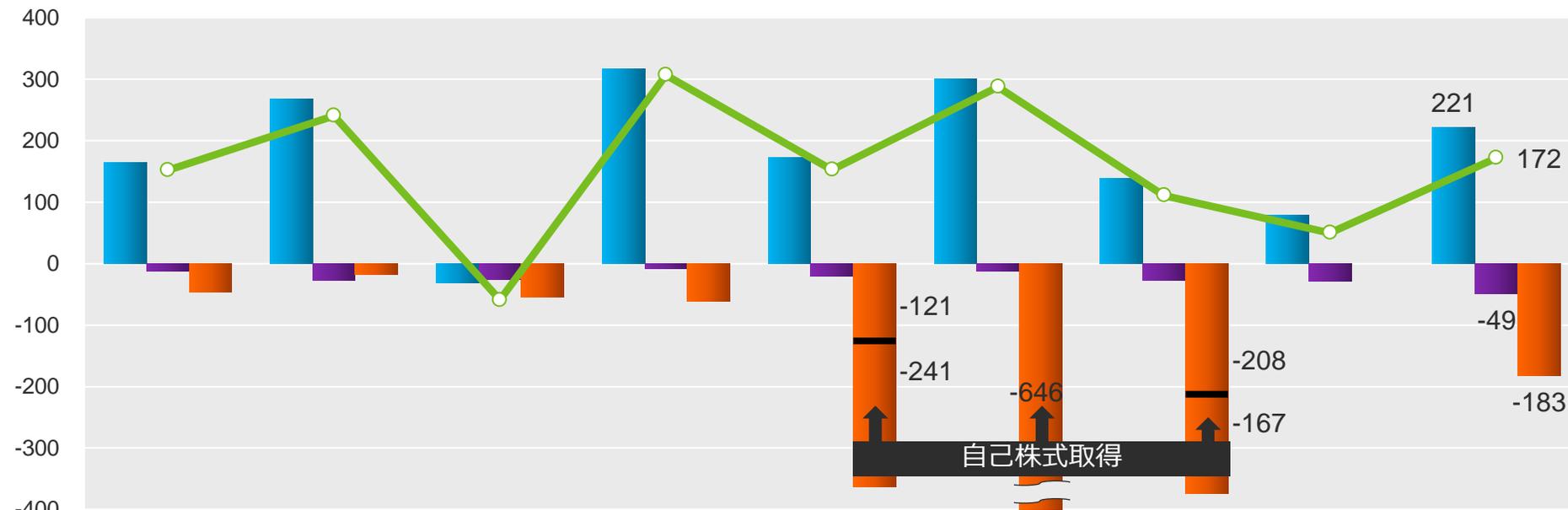
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)

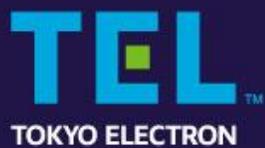


	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17
営業キャッシュ・フロー	164	268	-32	317	173	301	138	79	221
投資キャッシュ・フロー*	-12	-27	-26	-9	-20	-12	-27	-29	-49
財務キャッシュ・フロー	-46	-18	-54	-62	-363	-646	-375	0	-183
フリーキャッシュ・フロー**	152	241	-59	307	153	288	111	50	172
手元資金残高***	2,800	2,991	2,853	3,176	2,989	2,607	2,338	2,366	2,309

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

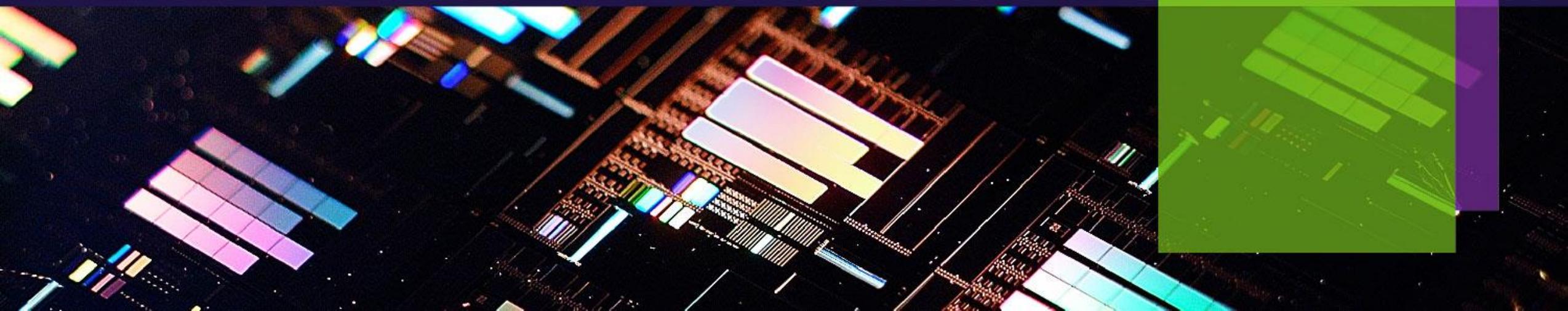


事業環境および業績予想

2016年7月29日

河合 利樹

代表取締役社長、CEO



事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2016の半導体前工程（WFE*）の設備投資額は、前年同水準を見込む

- メモリ：3D NAND向けが拡大。DRAM向けは一巡
- ファウンドリ／ロジック：先端ノード向け投資が予定通り好調

▶ FPD設備投資

CY2016のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資を中心に、前年比20%の増加を見込む

(2016年7月時点での見方)

装置市場は3D NAND、先端ロジックの立ち上がりにより堅調

* WFE (Wafer Fab Equipment)：半導体製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
WFEは、前工程で使用される製造装置です。

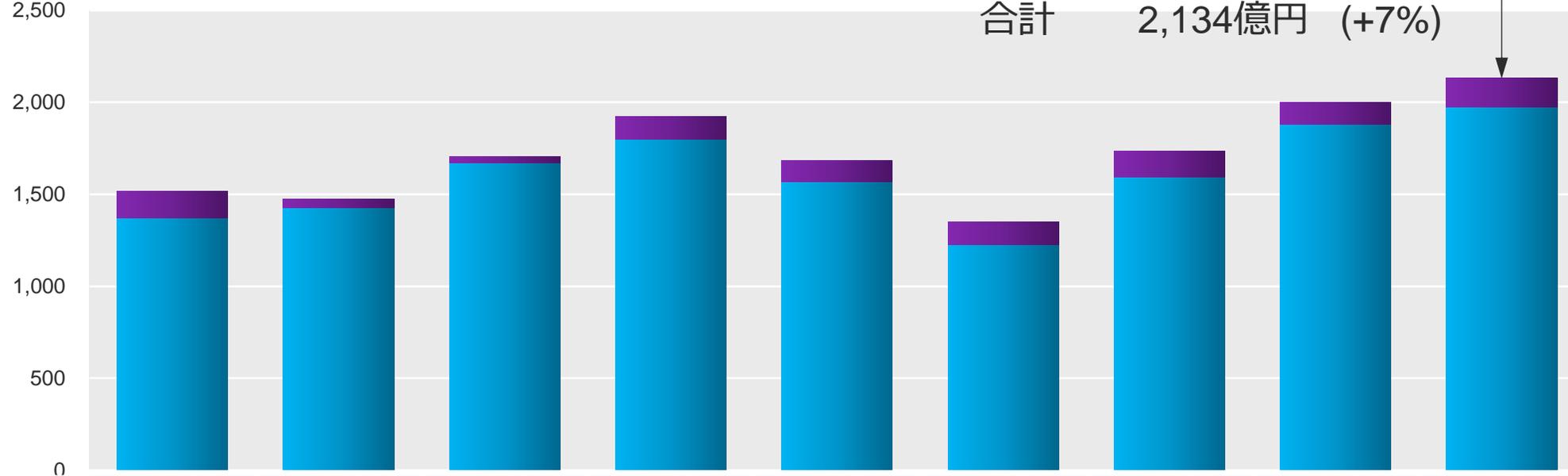
** TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

四半期 受注額・受注残高

2016/4-6月期

SPE	1,974億円	(+5%)
FPD	159億円	(+31%)
合計	2,134億円	(+7%)

(億円)



	14/4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6
SPE受注額	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224	1,593	1,878	1,974
FPD受注額	142	48	34	126	118	125	139	122	159
SPE受注残高	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767	2,226	2,354	2,737	3,403
FPD受注残高	293	291	288	316	333	376	399	374	363

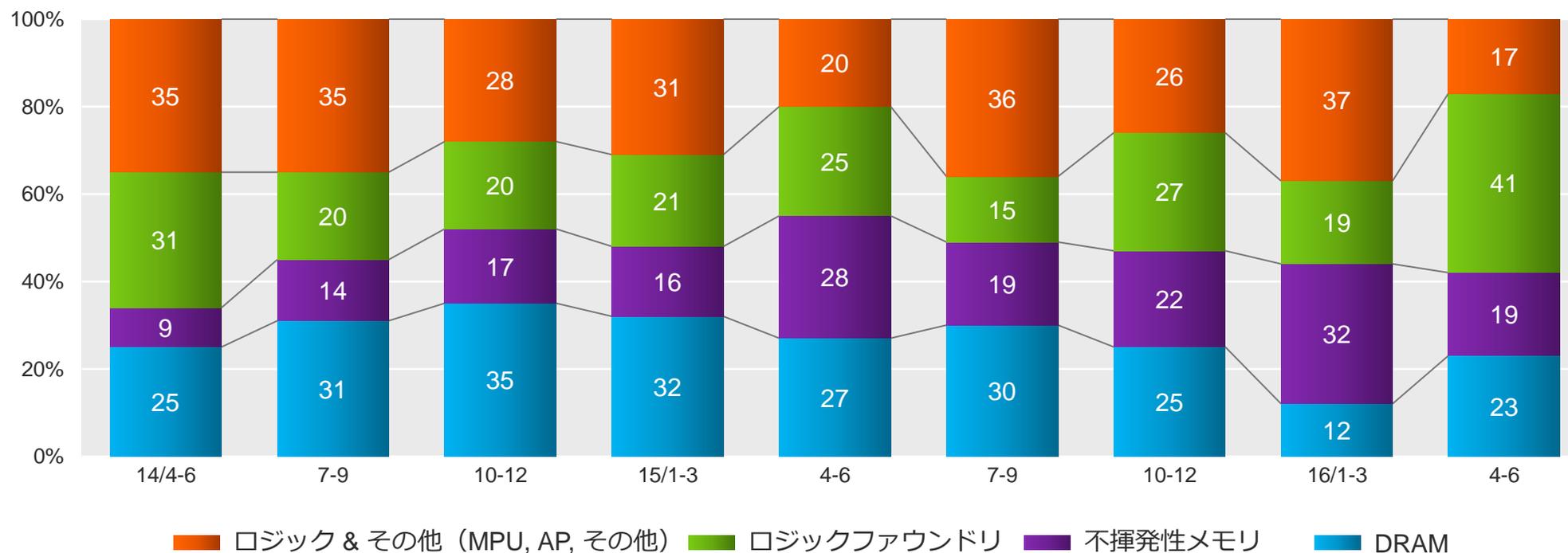
ファウンドリの先端ノード向けが牽引、2007年4-6月期以来で最高の受注

2016年4-6月期 受注増加の背景

- ファウンドリ向けが、受注増加を大きく牽引
 - モバイルの高機能化が10nm世代の先端ロジック半導体の需要を拡大
 - 中国市場向けに28nm以前の幅広い世代への投資も増加
- 3D NAND/DRAM向け投資も堅調
- FS*事業の受注は、前四半期比で約20%の増加となる高水準

*FS: フィールドソリューション

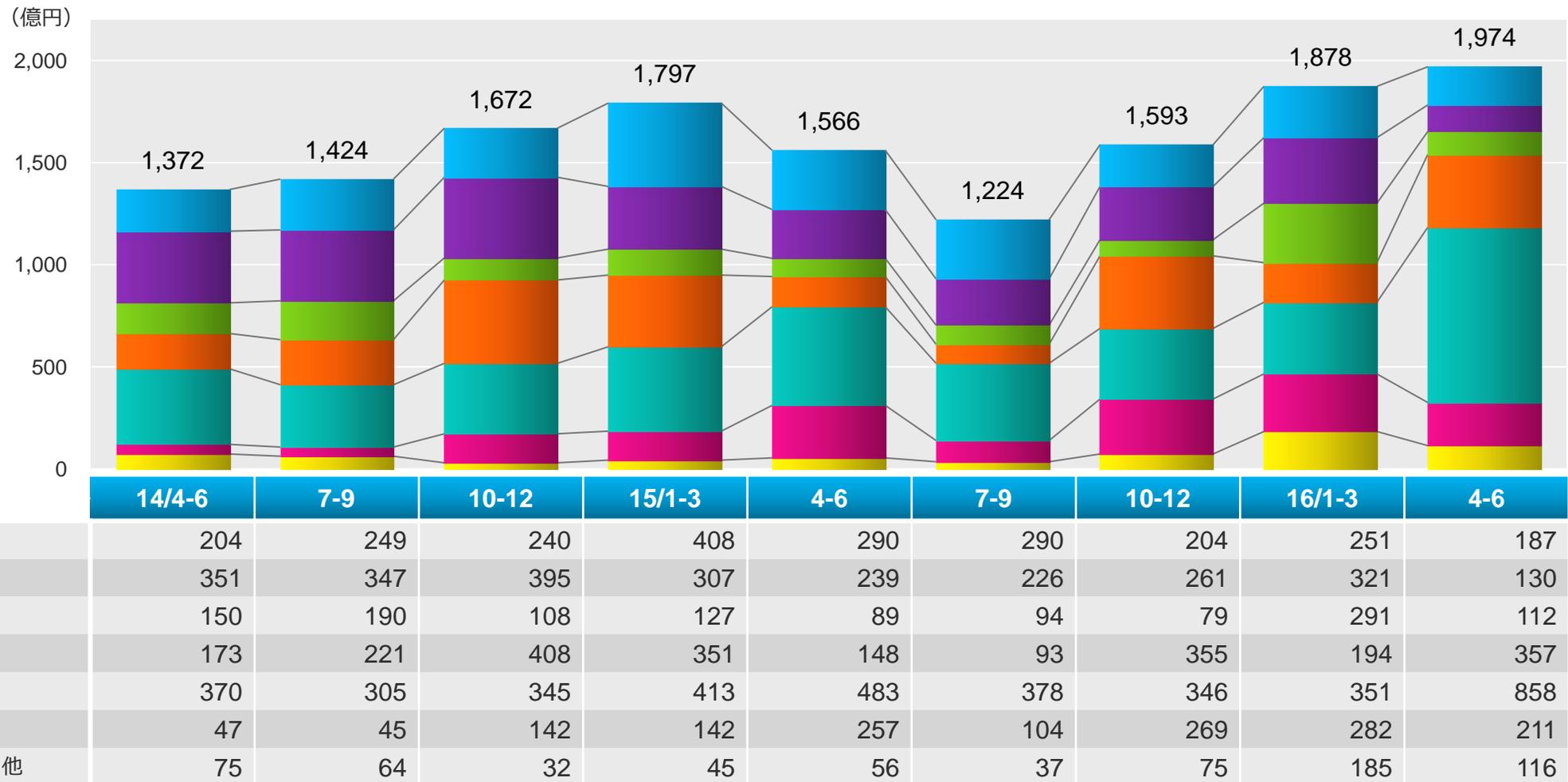
SPE受注アプリケーション別構成比



ファウンドリ向け四半期受注額が過去最高

グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額



台湾のファウンドリと韓国のメモリ向けが伸長

2017年3月期 業績予想

2017年3月期 業績予想 (2016/5/12発表から変更なし)

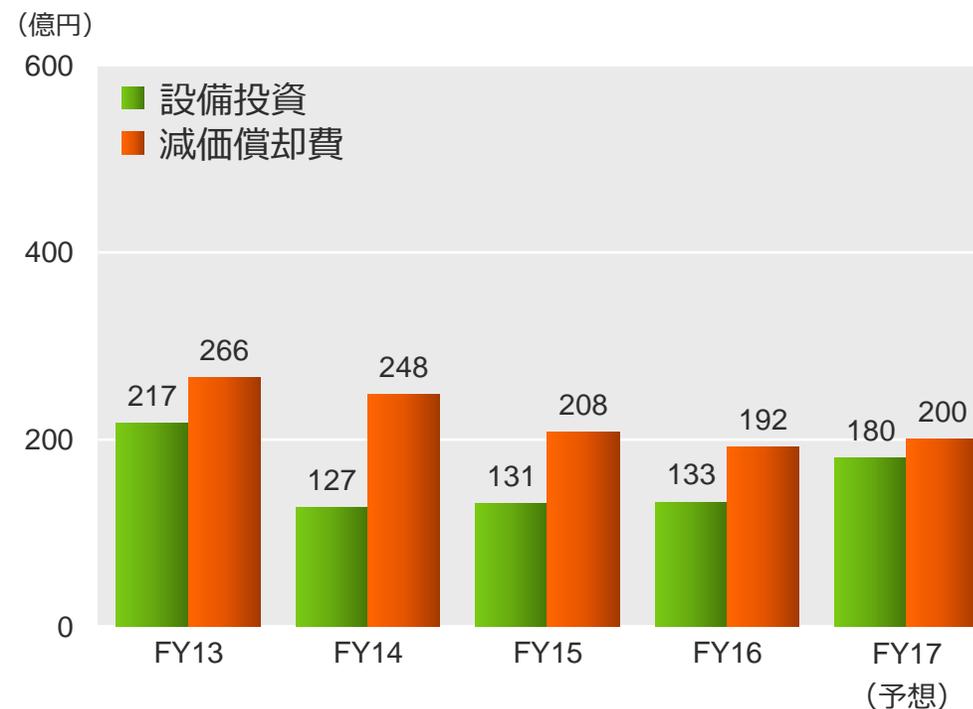
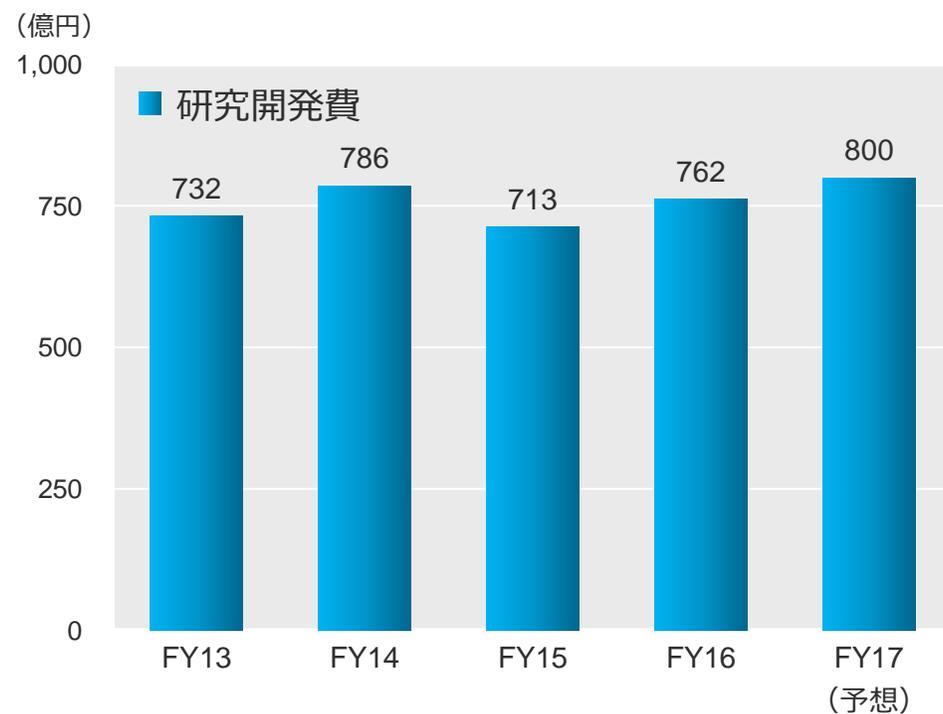
(億円)

	FY2016 (実績)	FY2017 (予想)				対前年増減
		上期	下期	通期		
売上高	6,639	3,300	3,840	7,140	+7.5%	
SPE	6,130	3,040	3,610	6,650	+8.5%	
FPD	446	260	230	490	+9.7%	
営業利益	1,167	490	750	1,240	+73	
下段：営業利益率	17.6%	14.8%	19.5%	17.4%	-0.2pts	
特別損益	-129	-100	-	-100	+29	
税前利益	1,064	390	750	1,140	+76	
親会社株主に帰属する 当期純利益	778	290	560	850	+72	
1株当たり配当金 (円)	237	89	171	260	+23	

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

前期に対し、さらなる増収増益を見込む

研究開発費・設備投資計画 (2016/5/12発表から変更なし)



成長分野への開発費および設備投資を増加

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ